

ファブレスLSIメーカーの台頭が予想される
 半導体関連プレーヤーの動向と関連市場を調査

■半導体世界市場は2019年に47兆1,600億円（2014年比33.8%増）

マーケティング&コンサルテーションの株式会社富士キメラ総研（東京都中央区日本橋小伝馬町 社長 田中 一志 03-3664-5839）は、IoTやウェアラブル時代の到来に向け変動する半導体業界と次世代プロセス技術の開発／導入状況に関する調査を実施した。

その結果を報告書「2015 半導体関連プレーヤーの最新動向調査」にまとめた。

この報告書ではIDM（Integrated Device Manufacturer：垂直統合型デバイスメーカー）12社、ファブレスLSIメーカー6社、ファウンドリー5社、OSAT（Outsource Assembly and Test：後工程受託メーカー）5社の動向を整理するとともに、注目半導体デバイス／パッケージ8品目、半導体関連材料7品目について市場の現状を調査・分析し、将来を予測した。

<調査結果の概要>

■半導体の世界市場

2014年	2019年予測	2014年比
35兆2,481億円	47兆1,600億円	133.8%

2014年の市場は前年比18.1%増となり、スマートフォンをはじめとした情報通信機器が市場をけん引した。半導体プロセスの微細化が進み、スマートデバイスが低価格で入手できる環境が整い、新興国を中心に普及が加速した。今後も新興国におけるデジタル機器の需要増加により、市場は拡大するとみられる。

現在の半導体市場の成長を支えているのは、スマートフォンをはじめとした情報通信機器である。需要地域としては、圧倒的な人口を有し経済成長が続く中国が中心である。中国では中国スマートフォンメーカーが台頭しているものの、半導体は国外メーカーに依存している。そのため、中国メーカーの育成に力を入れて、国産化の比率を高めている。また、中国では設計・開発、前工程、後工程の分業が一般的であり、ファブレスLSIメーカーとファウンドリー、OSATが主要なプレーヤーとなっている。なお、パワー半導体の分野ではIDMの成長も予想される。

グローバル半導体メーカーは巨大市場である中国を重視している。現在はスマートフォンが中心であるが、今後は自動車やIoT／インフラ関連市場の本格的な立ち上がりにより重要性が増すと考えられるため、各メーカーはさまざまなビジネスモデルで中国へのアプローチを進めている。中国に工場を建設し需要の取り込みやコストダウンを進めるメーカーや、中国メーカーとの提携を進めるメーカーもある。パワー半導体についても提携など同様の動きがみられる。

■各半導体業界の2014年から2015年にかけての動向と将来展望

業界	2014年から2015年にかけての動向	将来展望
IDM	<ul style="list-style-type: none"> ・メモリー関連はモバイル向け中心に好調。 ・CPUメーカーはPC市場の停滞やファブレスLSIメーカーとの競合により伸び悩み。 ・パワー半導体やマイコン関連は好調を維持。 	<ul style="list-style-type: none"> ・モバイルやサーバー向けの需要が継続するためメモリー系は好調を維持する。 ・多くのメーカーはアナログやパワー系、ミックスドシグナル、マイコンなど特徴のある製品中心へ徐々にシフトする。 ・微細化プロセスを持つメーカーはファウンドリー事業を拡大。

ファブレスLSIメーカー	<ul style="list-style-type: none"> ・スマートフォン向けSOCを中心に、市場が大きく拡大。 ・通信系デバイスメーカーも好調を維持。 	<ul style="list-style-type: none"> ・モバイル向けのみならず、さまざまなデバイスで台頭する。 ・中国メーカーの高成長が続く。
ファウンドリー	<ul style="list-style-type: none"> ・ファブレスLSIメーカーの好調を受けて市場拡大が続く。 ・IDMのファブライツ戦略による受託増加も市場拡大を後押ししている。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ファブレスLSIメーカーの成長を受けて市場は拡大。微細化プロセスを中心にIDMのファブライツ戦略が加速するためIDM向けの受注も拡大。 ・一部のメーカーではWLCSPも製造し、後工程も取り込む動きが本格化する。
OSAT	<ul style="list-style-type: none"> ・ファウンドリーと同様、ファブレスLSIメーカーの好調を受けて市場拡大。 ・IDMの工場売却や投資抑制によりIDMからの受注も増加傾向。 	<ul style="list-style-type: none"> ・各社はWLCSPやFCなどの高付加価値パッケージを強化。ローエンドパッケージを中心にメーカー間の統合などが進む。 ・IDM向けの受注も増加し市場は拡大。

<調査対象>

企業	IDM	12社	Intel、Samsung El.、Micron Technology、SK Hynix、Texas Instruments、東芝、STMicroelectronics、ルネサス エレクトロニクス、Infineon Technologies、NXP Semiconductors、ソニー、Freescale Semiconductor
	ファブレスLSIメーカー	6社	Qualcomm、Broadcom、MediaTek、Xilinx、Spreadtrum、Leadcore
	ファウンドリー	5社	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company、GLOBALFOUNDRIES、United Microelectronics Corporation、Semiconductor Manufacturing International Corporation、TowerJazz
	OSAT	5社	Advanced Semiconductor Engineering、Amkor Technology、Siliconware precision Industries、Jiangsu Changjiang Electronics Technology、ジェイデバイス
注目半導体デバイス ／パッケージ	8品目	CPU、DRAM、NAND、イメージセンサー、MEMSデバイス、車載マイコン、レギュレーター、WLCSP (Fan-In/Fan-Out)	
半導体関連材料	7品目	シリコンウェハ、CMPスラリー、半導体用レジスト、high-k材料、フリップチップ基板、封止材料／アンダーフィル、バッファコート／再配線用材料	

<調査方法>富士キメラ総研専門調査員によるヒアリング及び関連文献、データベース活用による調査・分析

<調査期間>2015年2月～5月

以上

資料タイトル：「2015 半導体関連プレーヤーの最新動向調査」
体 裁：A4判 304頁
価 格：190,000円+税
CD-ROM付価格 200,000円+税
調査・編集：株式会社 富士キメラ総研 研究開発本部 第一研究開発部門
TEL：03-3664-5839 FAX：03-3661-1414
発行所：株式会社 富士キメラ総研
〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町12-5 小伝馬町YSビル
TEL：03-3664-5839 (代) FAX：03-3661-1414
e-mail：info@fcr.co.jp
この情報はホームページでもご覧いただけます。
URL：http://www.group.fuji-keizai.co.jp/ http://www.fcr.co.jp/